

公司代码：600360

公司简称：华微电子

吉林华微电子股份有限公司  
2020 年半年度报告摘要

## 一 重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配或资本公积转增股本。

## 二 公司基本情况

### 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华微电子	600360	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏增文（代）	李铁岩
电话	0432-64684562	0432-64684562
办公地址	吉林省吉林市高新区深圳街99号	吉林省吉林市高新区深圳街99号
电子信箱	hwdz99@hwdz.com.cn	hwdz99@hwdz.com.cn

### 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,546,863,192.51	5,751,631,052.89	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	3,102,356,733.53	3,107,831,715.78	-0.18
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	173,988,722.28	135,526,294.91	28.38
营业收入	803,346,536.71	725,082,458.56	10.79
归属于上市公司股东的净利润	18,532,400.35	36,073,286.86	-48.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,831,905.50	31,632,403.74	-49.95

加权平均净资产收益率 (%)	0.59	1.42	减少0.83个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	0.04	-50.00

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)		135,535				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海鹏盛科技实业有限公司	境内非国有法人	22.40	215,916,656	0	质押	140,377,673
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.31	12,655,403	0	未知	
李金海	未知	0.91	8,758,600	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.91	8,725,424	0	未知	
成雅芝	未知	0.57	5,480,000	0	未知	
戴红	未知	0.43	4,104,164	0	未知	
冯群侠	未知	0.30	2,871,533	0	未知	
王衍斌	未知	0.30	2,860,000	0	未知	
姚颖臻	未知	0.29	2,784,219	0	未知	
吕大海	未知	0.28	2,668,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

# 三 经营情况讨论与分析

## 3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，受中美贸易摩擦等外部不确定性因素影响，加速了半导体芯片国产化进程。公司紧紧抓住国产化替代契机，以产业政策为指导，充分发挥自身产品、技术优势，持续推进“产品结构、客户结构、市场结构”调整。同时，加大产品研发投入，加快产品市场推广力度，实现了公司产品在中高端市场的规模化应用。同时，公司充分发挥功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测试为一体的 IDM 企业技术研发优势，积极布局第三代半导体，加速产品转型以及向战略性新兴产业领域的拓展的速度，为公司可持续发展、提升盈利能力以及主营业务增长奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 803,346,536.71 元，同比增长 10.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,532,400.35 元，同比下降 48.63%。

报告期内，公司继续推进职能整合优化工作，垂直整合芯片制造资源，打造芯片制造平台、核心产品工艺技术平台，调整产品结构、优化生产周期、提高产能效率和提升市场交付能力。核心产品分为四大主类，以 IGBT（绝缘栅双极晶体管）、MOSFET（场效应晶体管）、BJT（双极晶体管）为主的全控型功率器件；以 Thyristor（晶体闸流管）为主的半控型功率器件；以 Schottky（肖特基二极管）、FRD（快恢复二极管）为主的不可控型功率二极管器件；以及 IPM（功率模块）。产品种类基本覆盖了功率半导体器件的全部范围，广泛应用于新能源汽车、光伏、变频、工业控制、消费类电子等领域，在深度挖潜半导体功率器件开发的同时，公司产品结构调整进展迅速，在上半年推出了 TVS（瞬态抑制二极管）、Zener（齐纳二极管）、TSS（半导体放电管）等半导体保护器件。推进全员降本增效，积极挖潜增效空间，通过工艺优化、设备自主调试、备品备件国产化替代、能效管控等手段，增加利润空间；通过远程办公，使公司物流、人员、财务、市场信息等讯息能快速、准确地传输，数据在各业务系统之间高度共享，优化企业资源，提升业务流程效率，降低企业运营成本；严控销售费用、管理费用、融资费用支出，持续加大研发资金投入，支持公司产品研发快速推进，不断提升公司核心竞争优势，实现可持续发展。

公司通过加快数字化、信息化建设，不断完善 ERP、MES、BPM 管理，有效提高生产、经营、管理效率。通过 PLM 系统落地，加强项目、工艺、BOM 管理，提高开发速度，实现产品全生命周期管理。大力推动两化融合管理体系发展，完善企业信息化环境下新型能力，加快企业数字化转型进程，确保公司经营活动有效实施。

2020 年下半年，公司将继续稳步开拓国内外市场，通过新产品，新领域的市场拓展，促进公司主营业务和利润的增长。同时，通过多元化产品系列平台的合理搭配，有效提升产能利用率，

进一步降低产品成本，努力提升公司经营业绩，确保公司平稳发展，切实保障广大股东特别是中小股东的利益，努力回报股东对公司发展给予的支持。

**3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起开始执行。

**3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。**

适用 不适用